

2020-2026年中国晶圆代工 市场评估与投资战略咨询报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2020-2026年中国晶圆代工市场评估与投资战略咨询报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202006/169560.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

晶圆制造属于技术及资本密集型行业，其最关键的技术为制造流程的精细化技术，为攻克最先进制程需巨额资本开支及研发投入。行业寡头竞争特征愈发明显，2016年全球前十大纯晶圆代工企业联合市场份额达94.2%。大陆IC设计市场增长远高于全球，下游广袤市场吸引国内外厂商纷纷在大陆增设晶圆产能，抢食高速增长的大陆市场份额。当前中国大陆12寸及8寸现有晶圆产线合计36条（包括现有产线20条，在建及计划16条），其中超过50%的晶圆产线（包括现有12条，在建及计划8条）均集中在存储器或IDM业务（包括：三星、英特尔、SK海力士三大国际IDM厂商在大陆的晶圆产线，和大陆长江存储、晋华集成、士兰微等企业的晶圆产线），与纯晶圆代工业务重合度较小。外资晶圆代工厂产能扩张均较为平稳；2021年大陆12寸晶圆代工厂产能将达457K/m，2016-2021年间复合增速达24%，在内资及外资晶圆厂的共同推动下预计将进入快速扩张状态。2016-2021年间大陆8寸内资晶圆厂及外资晶圆厂产能复合增速预测 - 220K（34%） 429K（66%） 2021年预计总产能及占比 281K（32%） 584K（68%） 2016-2021E CAGR 5% 6.40% 2016-2021年间大陆12寸内资晶圆厂及外资晶圆产能复合增速预测 - 16K（12%） 116K（88%） 2021年预计总产能及占比 98K（21%） 359K（79%） 2016-2021E CAGR 44% 25% 中企顾问网发布的《2020-2026年中国晶圆代工市场评估与投资战略咨询报告》共四章。首先介绍了中国晶圆代工行业发展环境、晶圆代工整体运行态势等，接着分析了中国晶圆代工行业市场运行的现状，然后介绍了晶圆代工市场竞争格局。随后，报告对晶圆代工做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国晶圆代工行业发展趋势与投资预测。您若想对晶圆代工产业有个系统的了解或者想投资中国晶圆代工行业，本报告是您不可或缺的重要工具。本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录第一章晶圆制造简介21第一节晶圆制造流程21第二节晶圆制造成本分析27第二章半导体市场32第一节2018-2023年半导体产业预测32第二节2019年半导体市场下游预测34第三节全球晶圆代工产业现状35第四节全球半导体制造产业38一、全球半导体产业概况38二、全球晶圆代工行业概况39第五节中国半导体产业与市场44一、中国半导体市场44二、中国半导体产业47三、中国ic设计产业56四、中国半导体产业发展趋势59第三章晶圆代工产业简介61第一节晶圆制造工艺简介61第二节全球晶圆产业及主要厂商简介62第三节中国半导体产业政策环境70第四节中国晶圆制造业现状及预测73合各晶圆代工厂中国区营收及晶圆ASP，预计2018H1大陆市场晶圆代工出货量合计约4400K。考虑到大陆厂商ASP相对更低，市场出货

份额进一步向大陆厂商集中达67%。分厂商而言，台积电占据大陆市场最大出货，但份额收窄至28%。中芯国际以22%的份额紧随其后，华虹则以11%的市占率跻身前三。2018H1大陆晶圆代工出货份额分布2018H1大陆晶圆代工销售份额分布 第四章晶圆厂研究76一、中芯国际76（一）企业偿债能力分析77（二）企业运营能力分析79（三）企业盈利能力分析82二、上海华虹nec电子有限公司83（一）企业偿债能力分析85（二）企业运营能力分析87（三）企业盈利能力分析90三、上海宏力半导体制造有限公司92（一）企业偿债能力分析93（二）企业运营能力分析95（三）企业盈利能力分析98四、华润微电子99（一）企业偿债能力分析100（二）企业运营能力分析102（三）企业盈利能力分析105五、上海先进半导体106（一）企业偿债能力分析107（二）企业运营能力分析109（三）企业盈利能力分析112六、和舰科技（苏州）有限公司113（一）企业偿债能力分析114（二）企业运营能力分析116（三）企业盈利能力分析119七、bcd（新进半导体）制造有限公司120（一）企业偿债能力分析121（二）企业运营能力分析123（三）企业盈利能力分析126八、方正微电子有限公司127（一）企业偿债能力分析128（二）企业运营能力分析130（三）企业盈利能力分析133十、南通绿山集成电路有限公司134（一）企业偿债能力分析135（二）企业运营能力分析137 图表目录：图表1晶圆制造工艺流程21图表2晶圆尺寸变化影响加工成本趋势分析27图表32019年度全球营收前13的晶圆代工企业35图表42018-2023年大陆ic内需市场规模变化与预测36图表5主要代工企业产能分布及收益情况41图表6集成电路技术节点及其对应研发和建厂费用43图表7全球半导体市场规模超过3000亿美元47图表8半导体产品种类繁多48图表9全球半导体分产品市场占比48图表10中国大陆半导体市场规模近4000亿元49图表11全球半导体产业区域结构发生巨大变化50图表12北美半导体设备制造商bb值51图表13半导体产业链51图表14近期或者未来有望在a股上市的半导体厂商52图表15半导体产业链上封测环节技术壁垒相对较低53图表16封测环节在半导体产业链中的相对进入壁垒54图表17集成电路封测行业一直占据行业主导地位55图表18国内十大半导体封装测试企业56图表192019年全球晶圆代工排名63图表202015-2019年全球前三大半导体厂商营收与成长趋势64图表21全球半导体厂商资本支出占营收比例之比较65图表22前三大半导体厂商资本支出与占营收比例趋势66图表23全球半导体厂商资本支出集中程度分析67图表24半导体设备厂商于18寸晶圆生产设备投资考虑情境分析68图表25全球半导体设备产业版图的变化69图表26国内政策对集成电路产业大力支持71图表27国内半导体进口金额超2000亿美元71

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202006/169560.html>